

## JDB910 N15 有机硅导热凝胶

### 产品描述

JDB910 N15是一种挤出性好，双组分加成型导热凝胶，兼具有优异的导热性能和良好的电器绝缘性能，使其非常适应用于电机、功率半导体、晶体闸流管、整流器和变压器等设备或器件的封装。

### 产品特性

- 抵抗湿气，污物和其它大气组分；
- 无溶剂，无固化副产物，容易修补；
- 减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张力；
- 在-50~200℃间稳定的机械和电气性能；
- 阻燃性能优异，通过了 UL94V0 认证（UL FileNo.E343835），完全符合欧盟 ROHS 指令要求。

### 产品用途

用于电机及大功率电子元器件等的散热和封装保护，尤其是对导热性能要求较高的元器件等。

### 主要性能

项目	典型值		测试标准	
<b>混合前物性</b> (23±2℃/50±5%RH )				
组分	--	A	B	--
外观	--	灰色膏体	白色膏体	--
粘度 Brookfield DV2T 7#转子, 转速 10r/min	Pa•s	550±50	550±50	GB/T 2794-2013
比重	g/cm <sup>3</sup>	1.9±0.10	1.9±0.10	GB/T 533-2008
<b>混合后物性</b> (23±2℃/50±5%RH )				
重量比混合	--	A:B=1:1		GB/T 533-2008
外观	--	灰色膏体		---
粘度 Brookfield DV2T 7#转子, 转速 10r/min	Pa•s	550±50		GB/T 2794-2013
可操作时间 (100G)	min	30-90		--
完全固化时间(100G)	--	25℃/24Hours; 80℃/30Min		GB/T 13477.5-2002
<b>固化后性能</b> ( 23±2℃/50±5%RH×24hours )				
硬度	Shore00	40±5		GB/T 531.1—2008

导热系数	W/m·K	1.5±0.2	ISO22007-2
介电强度	kV/mm	≤15	GB/T 1408.1—2006
介电常数(60HZ)	--	≤4.0	GB/T 1409—2006
体积电阻率	Ω·cm	≥1.0×10 <sup>14</sup>	GB/T 1410—2006
介电损耗(60HZ)	--	0.02	GB/T 1409—2006
工作温度	℃	-50~200	--

## 使用说明

- 将被施胶物体的表面清理干净，并保持洁净表面干燥。
- 混合后可用真空方式去除夹带空气，在28”Hg的真空度下抽气，2分钟可去除气泡，大容积时可延长抽空气时间。
- 产品室温下快速固化，24小时内完全固化。

## 注意事项

- 使用前，请详细查阅MSDS。
- 胶料应密封贮存，混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
- 本品属非危险品，但避免接触皮肤及眼睛。
- 长时间存放后，胶中的填料会有所沉降。请搅拌均匀后使用，不影响性能。
- 胶液接触一定量的以下化学物质会导致胶不固化：
  - 1、含N、P和S等的有机化合物。
  - 2、含Sn、Pb、Hg和As等元素的离子性化合物。
  - 3、含炔烃及多乙烯基的化合物。
- 为了避免上述现象，胶液灌封使用前，应尽量擦干净器件上面残留的松香，尽量使用低铅含量的焊锡。

## 包装规格

- A组分，20kg/桶 B组分，20kg/桶
- 400ml 双组份胶管

## 储存及运输

- 远离儿童存放，保持A、B组分避光和避热，并且密封保存。
- 在28° C或低于该温度未开封保存时，产品自生产之日起保质期为6个月。
- 本产品为非危险品，按一般化学品贮存、运输。

## 请仔细阅读

这里包含的所有数据是在嘉多宝实验室测得，仅提供产品选型参考。我们建议在您的实验室或工厂进行足够的测试，以确定该产品是否满足您的所有要求。